

TIF™600 系列熱傳導界面材料是填充發熱器件和散熱片或金屬底座二者之間的空氣間隙。它們的柔性、彈性特征使其能夠用於覆蓋非常不平整的表面。

其優異的效能使熱量從發熱器件或整個PCB傳導到金屬外殼或擴散板上，從而能提高發熱電子組件的效率和壽命。

特性

- 》良好的熱傳導率: **4.7 W/mK**
- 》帶自粘而無需額外表面黏合劑
- 》高可壓縮性,柔軟兼有彈性,適合於在低壓力應用環境
- 》可提供多種厚度選擇

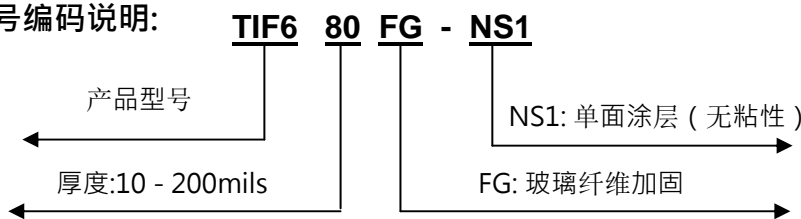
應用

- 》散熱器底部或框架
- 》機頂盒
- 》電源與車用蓄電池
- 》充電樁
- 》LED電視 LED燈具
- 》RDRAM內存模塊
- 》微型熱管散熱器

TIF600 系列特性表

顏色	藍紫色	Visual	击穿电压(T= 1mm 以上)	>5000 VAC	ASTM D149
結構&成份	陶瓷填充矽膠	*****	介電常數	7.5 MHz	ASTM D150
導熱率	4.7 W/mK	ASTM D5470	體積電阻率	8.0X10 ¹³ Ohm-meter	ASTM D257
硬度	45 Shore 00	ASTM 2240	使用溫度範圍	-40 To 160 °C	*****
比重	2.88 g/cc	ASTM D297	總質量損失 (TML)	0.35%	ASTM E595
厚度範圍	0.010"-0.200" (0.25mm-5.0mm)	ASTM D374	防火等級	94 V0	UL E331100

產品型號編碼說明:

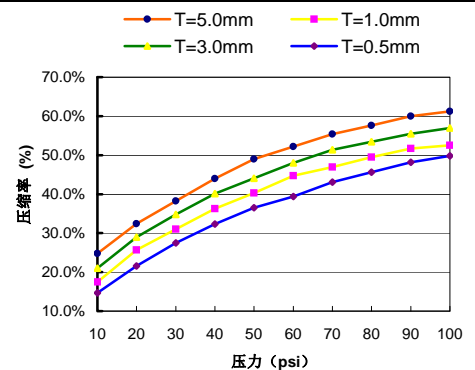


標準厚度:

0.010-inch to 0.200-inch (0.25mm to 5.0mm)

選項:

特殊NS1處理後可以讓產品單面無粘性



如果您想了解更多導熱材料的產品信息，請訪問我司官網：<http://www.ziitek.com>

導熱灌封膠 | 相變化材料 | 導熱矽膠布 | 導熱膏 | 導熱雙面膠 | 導熱矽膠片 | 陶瓷散熱片 | 石墨片 | 導熱塑料

加拿大:
Tel: +001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

台灣:
Tel: +886-2-22771007
Fax: +886-2-22771075
E-mail: jerry@ziitek.com.tw

東莞:
Tel: +86-769-38801208
Fax: +86-769-83791290
E-mail: angus@ziitek.com

昆山:
Tel: +86-512-57816297
Fax: +86-512-57816327
E-mail: kelvin@ziitek.com

成都:
Tel: +86-28-62379168
Fax: +86-28-62379168
E-mail: david_cd@ziitek.com

以上資料與說明相信是可靠的但不作為法律的解釋或保證。用戶須進行充分的測試與確認上述訊息適合用戶所提出任何特殊的產品與應用。